

高云的产品变更通知（GPCN）

概述

感谢您使用高云 FPGA 系列器件，此通知的目的是通知受此变更影响的客户注意此次变更，本次变更是为了增加 QFN(0404-0.4)032 封装框架的供应商，以保证框架的供应。

描述

QFN(0404-0.4)032 封装框架供应商增加华天科技（宝鸡）有限公司。

变更前	<ol style="list-style-type: none">封装框架供应商：<ol style="list-style-type: none">天水华洋电子科技有限公司宁波康强电子股份有限公司新恒汇电子股份有限公司封装框架尺寸：2.850X2.850-1B-0.203T-0001封装框架材质：A194封装框架表面处理类型：全镀银
变更后	<ol style="list-style-type: none">封装框架供应商<ol style="list-style-type: none">天水华洋电子科技有限公司宁波康强电子股份有限公司新恒汇电子股份有限公司<u>华天科技（宝鸡）有限公司</u><ol style="list-style-type: none">封装框架尺寸：2.850X2.850-1B-0.203T-0001封装框架材质：A194封装框架表面处理类型：<u>全镀银+粗化</u>

受影响的产品

封装形式为 QFN(0404-0.4)032 的产品（见附表 1 产品型号清单）。

客户影响

此变更未涉及产品外形、尺寸、功能、可靠性、质量及安全的变更，对客户应用无影响。

认证数据

高云已经完成并成功通过了所有必要的认证，可根据要求提供可靠性数据。

关键日期

高云将在变更发布 90 天后开始同时在中市场中供应不同框架的产品，使用不同框架的产品不会在单一生产批次中混合。

响应

请客户确认已收到此通知，如对此变更有任何问题或顾虑，请通知我们。如 30 日内没有响应，将默认已接受此变更。

附加文件

附表 1：产品型号清单

序号	封装形式	产品型号
1	QFN(0404*0.75-0.40)032	GW1N-LV1SFN32
2	QFN(0404*0.75-0.40)032	GW1NZ-LV1FN32
3	QFN(0404*0.75-0.40)032	GW1NZ-ZV1FN32

技术支持与反馈

广东高云半导体科技股份有限公司提供全方位技术支持，在使用过程中如有任何疑问或建议，可直接与公司联系：

网站：www.gowinsemi.com.cn

邮箱：support@gowinsemi.com

版本信息

日期	版本	说明
2023/08/03	1.0	初始版本。

版权所有©2022 广东高云半导体科技股份有限公司

GOWIN高云、Gowin、GowinSynthesis、云源以及高云均为广东高云半导体科技股份有限公司注册商标，本手册中提到的其他任何商标，其所有权利属其所有者所有。未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除高云半导体在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，高云半导体概不承担任何法律或非法律责任。高云半导体对高云半导体产品的销售和 / 或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。高云半导体对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，高云半导体保留修改文档中任何内容的权利，恕不另行通知。高云半导体不承诺对这些文档进行适时的更新。